

2020-2026年中国LED用 衬底材料产业发展现状与投资潜力分析报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2020-2026年中国LED用衬底材料产业发展现状与投资潜力分析报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202007/174513.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

硅衬底LED芯片是GaN基在硅衬底上制造的一种led芯片，硅衬底LED芯片问世不久，但是在硬度、导电性、导热性、价格及加工工艺上已经相较传统LED芯片有了明显的优势，受到业界的广泛关注。中企顾问网发布的《2020-2026年中国LED用衬底材料产业发展现状与投资潜力分析报告》分析了LED用衬底材料行业的产业链，竞争格局，面临的机遇及挑战以及发展前景等，您若想对中国LED用衬底材料行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录:第一章 led用衬底材料产业相关概述 第一节 半导体照明器件核心组成 第二节 led外延片 一、led外延片基本概述 二、led衬底材料发展对外延片环节的作用三、红黄光led衬底 四、蓝绿光led衬底 第三节 led芯片常用的三种衬底材料性能比较 一、蓝宝石衬底二、硅衬底三、碳化硅衬底 第四节 衬底材料的评价 第二章 2019年中国半导体照明（led）产业整体运行态势分析 第一节 2019年全球led产业现状与发展 一、世界半导体照明产业三足鼎立竞争格局形成二、国际半导体照明行业研究及应用进展分析三、全球led封装、芯片供需状况四、国际半导体照明行业发展的驱动因素分析五、半导体照明新兴应用领域 第二节 中国半导体照明产业链分析 一、我国的半导体照明产业链日趋完整二、上游环节 产业链三、中游环节（芯片制备）产业链四、下游环节（封装和应用）产业链 第三节 2019年中国半导体照明行业发展概况分析 一、我国的半导体照明产业发展初具规模二、中国半导体照明工程分析三、中国led设备产能状况分析四、中国led产业热点问题探讨 第四节 2019年中国半导体照明应用市场发展现状分析 一、中国led产品主要应用领域浅析 二、中国led应用市场发展概况分析三、新兴应用市场带动led行业发展 四、led光源大规模应用尚未成熟 第三章 2019年国内外led衬底材料产业运行新形势透析 第一节 2019年全球led衬底材料产业运行总况 一、产业运行环境及影响因素分析二、led衬底材料需求与应用分析 三、led衬底材料研究新进展 第二节 2019年中国led衬底材料产业现状综述 一、衬底技术进步快集成创新成led产业发展重点 二、衬底材料决定了半导体照明技术的发展路线三、衬底材料研究进展四、led产业对衬底材料的推动 第三节 2019年中国led衬底材料产业热点问题探讨 第四章 2011-2019年中国led衬底材料行业数据监测分析 第一节 2011-2019年中国led衬底材料行业规模分析 一、企业数量增长分析二、从业人数增长分析三、资产规模增长分析 第二节 2019年中国led衬底材料行业结构分析 一、企业数量结构分析二、销售收入结构分析 第三节 2011-2019年中国led衬底材料行业产值分析 一、产成品增长分析二、工业销售产值分析三、出

口 教货值分析第四节 2011-2019年中国led衬底材料行业成本费用分析一、销售成本统计二、费用统计第五节 2011-2019年中国led衬底材料行业盈利能力分析 一、主要盈利指标分析二、主要盈利能力指标分析 第五章 2019年中国led衬底材料细分市场分析——蓝宝石衬底 节 蓝宝石衬底基础概述一、蓝宝石衬底标准二、蓝宝石衬底主要类型和应用领域三、蓝宝石衬底主要技术参数及工艺路线四、外延片厂商对蓝宝石衬底的要求五、蓝宝石生产设备的情况第二节 2019年中国蓝宝石衬底材料市场动态聚焦 一、国产led蓝宝石晶片形成规模化生产二、下游扩张推动蓝宝石衬底需求持续走高 三、我国蓝宝石衬底白光led有很大突破 第三节 2019年中国蓝宝石项目生产分析 一、原料 二、生产线设备 三、2019年国内宝蓝石材料项目新进展 第四节 市场对蓝宝石衬底的需求分析 一、民用半导体照明领域对蓝宝石材料的需求分析二、民用航空领域对蓝宝石衬底的需求分析 三、军工领域对蓝宝石材料的需求分析 四、其他领域对蓝宝石材料的需求分析 第五节 蓝宝石衬底材料的发展前景 一、2019年全球led蓝宝石衬底的需求预测 二、2019年市场对led蓝宝石衬底的需求将暴增 三、蓝宝石衬底材料的发展趋势 第六章 2019年中国led衬底材料细分市场透析——硅衬底 节 半导体硅材料的概述 一、半导体硅材料的电性能特点 二、半导体硅材料的制备 三、半导体硅材料的加工 四、半导体硅材料的主要性能参数 第二节 硅衬底led芯片主要制造工艺的综述 一、si衬底led芯片的制造 二、si衬底led封装的技术 三、硅衬底led芯片的测试结果 第三节 硅衬底上gan基led的研究进展 一、用硅作gan led衬底的优缺点 二、硅作gan led衬底的缓冲层技术 三、硅衬底的led器件 第四节 2019年中国硅衬底技术产业化分析 第五节 2019年中国硅衬底发光材料批量生产情况 第六节 国内外市场对硅衬底材料市场的需求 一、led产业对硅衬底材料的需求潜力分析 二、硅衬底材料在其他新兴领域的需求 第七章 2019年中国led衬底材料细分市场探析——碳化硅衬底 节 碳化硅衬底的介绍一、碳化硅的性能二、硅衬底材料的优势三、碳化硅主要类型及应用领域四、碳化硅衬底标准 第二节 sic半导体材料研究的阐述一、sic半导体材料的结构 二、sic半导体材料的性能 三、sic半导体材料的制备方法 四、sic半导体材料的应用 第三节 sic单晶片cmp超精密加工的技术分析 一、sic单晶片超精密加工的发展 二、sic单晶片的cmp技术的原理 三、sic单晶片cmp磨削材料去除速率 四、sic单晶片cmp磨削表面质量 五、cmp的影响因素分析六、sic单晶片cmp抛光存在的不足七、sic单晶片的cmp的趋势 第四节 2019年国内外碳化硅衬底行业的需求分析 一、国内市场对碳化硅衬底的需求分析二、军事领域对碳化硅衬底的需求分析 第八章 2019年中国led衬底材料细分市场投视——申化镓衬底 节 申化镓的介绍一、申化镓的属性二、申化镓材料的分类第二节 申化镓外延片的加工技术一、申化镓外延片的工艺法二、led使用中对申化镓外延材料的性能要求第三节 申化镓衬底材料的发展一、国内申化镓材料主要生产厂家的情况二、申化镓外延衬底市场规模预测第四节 申化镓在光电子领域的应用一、申化镓在led方面的需求市场 二、我国led方面申化

镓的应用 第九章 2019年中国其他衬底材料市场分析节 氧化锌一、氧化锌的定义二、氧化锌的物理化性能指标三、氧化锌晶体应用及发展第二节 氮化镓一、氮化镓的介绍二、gan材料的特性 三、gan材料的应用 四、氮化镓晶体应用及发展五、氮化镓材料的应用前景广阔第三节 硼化锆一、硼化锆晶体概述二、硼化锆晶体应用及发展第四节 金属合金一、金属合金衬底概述二、金属合金衬底应用及发展第五节 其他晶体材料一、镁铝尖晶石二、 LiAlO_2 和 LiGaO_2 第十章 2019年中国led用衬底材料产业竞争态势分析 第一节 2019年中国led用衬底材料产业竞争格局分析 一、led用衬底材料业竞争程度 二、led用衬底材料竞争环境及影响因素分析三、中国衬底材料国际竞争力分析第二节 2019年中国led用衬底材料市场集中度分析第三节 2020-2026年中国led用衬底材料竞争趋势预测分析 第十一章 2019年国内及台湾led用衬底材料重点企业分析节 国外主要企业一、京瓷 (kyocera) 二、namiki 三、rubicon四、cree 第二节 中国台湾主要企业一、台湾越峰电子材料股份有限公司二、台湾中美硅晶制品股份有限公司三、台湾合晶科技股份有限公司四、台湾鑫晶钻科技股份有限公司 第十二章 2019年国内led用衬底材料重点企业运营关键性财务指标分析 第一节 水晶光电 一、企业基本概况 二、公司主要财务指标分析 三、企业成本费用指标 第二节 天通股份 一、企业基本概况 二、公司主要财务指标分析 三、企业成本费用指标 第三节 武汉博达晶源光电材料有限公司 一、企业基本概况 二、公司主要财务指标分析 三、企业成本费用指标 第四节 哈尔滨工大奥瑞德光电技术有限公司 一、企业基本概况二、公司主要财务指标分析三、企业成本费用指标 第五节 云南省玉溪市蓝晶科技有限责任公司一、企业基本概况二、公司主要财务指标分析三、企业成本费用指标第六节 成都聚能光学晶体有限公司一、企业基本概况二、公司主要财务指标分析三、企业成本费用指标第七节 青岛嘉星晶电科技股份有限公司一、企业基本概况二、公司主要财务指标分析三、企业成本费用指标第八节 爱彼斯通半导体材料有限公司一、企业基本概况二、公司主要财务指标分析三、企业成本费用指标 第十三章 2020-2026年中国led用衬底材料产业前瞻与新趋势探析 第一节 2020-2026年中国半导体照明 (led) 产业前景预测第二节 2020-2026年中国led用衬底材料趋势探析 一、氮化物衬底材料与半导体照明的应用前景二、led蓝宝石衬底晶体材料应用前景预测 三、led用衬底材料发展新趋势分析第三节 2020-2026年中国led用衬底材料市场前景预测 一、中国led用衬底材料市场需求预测分析 二、led衬底销售规模预测分析第四节 2020-2026年中国发展led用衬底材料带动作用分析及建议一、积极部署衬底材料产业发展布局将有效打开led上游产业环节二、led衬底材料的种类随着gan器件的发展而逐渐发展起来三、发展国内外延片环节 的重要力量 第十四章 2020-2026年中国led用衬底材料投资前景预测 205 () 第一节 2019年中国led用衬底材料投资概况 一、led用衬底材料投资环境分析二、led用衬底材料投资与在建项目分析 三、2011-2019年将是led照明产业佳投资时期 第二节 2020-2026年中国led用衬底材料投资机会分析一、led用衬底材料投资热点分析 二、与产业链相关的投资机会

分析第三节 2020-2026年中国led行业上游投资风险预警 一、宏观调控政策风险二、市场竞争风险（ ）三、技术风险四、市场运营机制风险第四节 投资观点

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202007/174513.html>